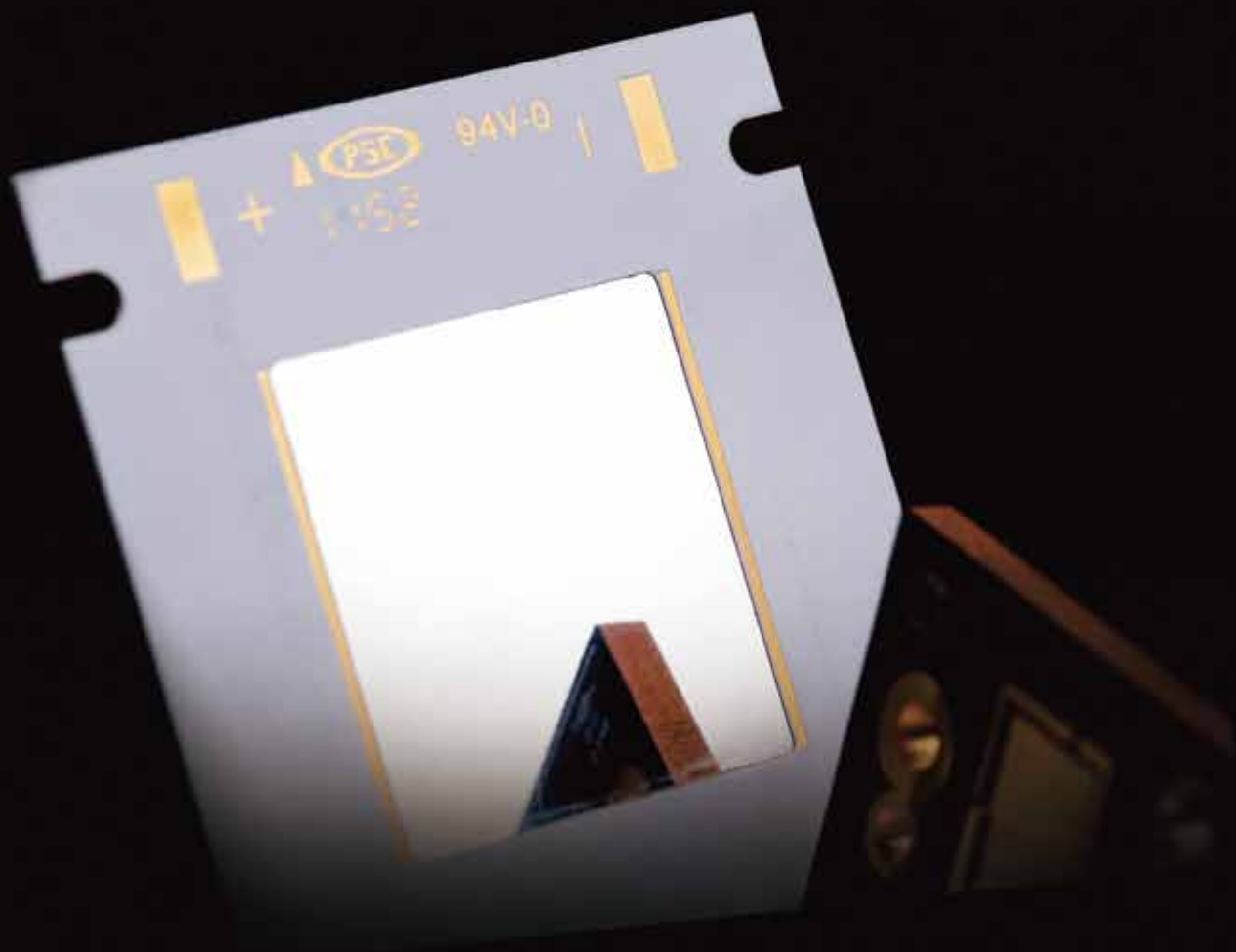




佳總興業股份有限公司

GIA TZOONG ENTERPRISE CO.,LTD.

江門佳泰電子有限公司

Jiangmen PSC Electronics LTD.

Professional PCB and MCPCB Manufacture



台灣佳總廠(桃園廠) Taiwan Plant

成立Established	19th SEP, 1988
員工人數Employees	500人, 500People
資本額Capital Investment	美金5000萬, US \$50 million
廠區面積Total Plant Area	264,000平方英尺, 264,000 sq.ft
目前月產能PCB Capacity	600,000平方英尺, 600,000 sq.ft
品質認證QA System	UL, ISO9001, ISO14001, TS16949

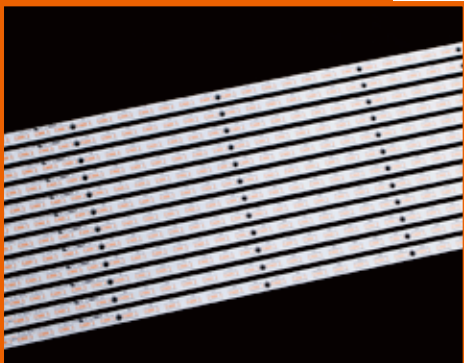


江門佳泰廠 China Plant

成立Established	May,2008
員工人數Employees	400人, 400People
資本額Capital Investment	美金2300萬, US \$23 million
廠區面積Total Plant Area	786,600平方英尺, 786,600 sq.ft
目前月產能PCB Capacity	350,000平方英尺, 350,000 sq.ft
品質認證QA System	UL, ISO9001, ISO14001

Light bar

鋁板Aluminum PCB



1. Material	材料種類：	5052 Aluminum 5052 鋁
2. Layer	層數：	1 L
3. Copper foil	銅箔：	1 oz.
4. Board Thickness	總板厚：	0.9 mm
5. conductively PP	導熱係數：	k=1~9 w/mk
6. Treatment	表面處理：	O.S.P 有機保焊劑
7. Solder Mask	防焊：	White 白
8. Application	產品應用：	Monitor / TV

疊構 Stack up



Cu L1
k=1~9 w/mk
Aluminum

鋁板Aluminum PCB



1. Material	材料種類：	5052 Aluminum 5052 鋁
2. Layer	層數：	2 L
3. Copper foil	銅箔：	1 oz.
4. Board Thickness	總板厚：	1.05 mm
5. conductively PP	導熱係數：	k=1~9 w/mk
6. Treatment	表面處理：	H.A.S.L 無鉛噴錫
7. Solder Mask	防焊：	White 白
8. Application	產品應用：	Monitor / TV

疊構 Stack up



Cu L1
k= 1~9 w/mk
Cu L2
k= 1~9 w/mk
Aluminum

FR-4 玻璃纖維板



1. Material	材料種類：	FR-4
2. Layer	層數：	2 L
3. Copper foil	銅箔：	1 oz.
4. Board Thickness	總板厚：	0.9 mm
5. Treatment	表面處理：	O.S.P 有機保焊劑
6. Solder Mask	防焊：	White 白
7. Application	產品應用：	Monitor / TV

疊構 Stack up



Cu L1
Glass fiber
Cu L2

CEM-3



1. Material	材料種類：	CEM-3
2. Layer	層數：	1 L
3. Copper foil	銅箔：	H oz.
4. Board Thickness	總板厚：	0.9mm
5. Iconductively pp	導熱係數：	k=1.5 w/mk
6. Treatment	表面處理：	O.S.P 有機保焊劑
7. Solder Mask	防焊：	White 白
8. Application	產品應用：	Monitor / TV

疊構 Stack up



Cu
CEM-3
Cu

Lighting

可彎折鋁板

Bendable Aluminum Board



疊構 Stack up

1. Material	材料種類：	1050 Aluminum 1050 鋁
2. Layer	層數：	1 L
3. Copper foil	銅箔：	1 oz.
4. Board Thickness	總板厚：	0.25 mm
5. conductivity pp	導熱係數：	k=1.5 w/mk
6. Treatment	表面處理：	O.S.P. 有機保焊劑
7. Solder Mask	防焊：	White 白
8. Application	產品應用：	LED Lighting 照明



鏡面鋁板

Mirror Aluminum PCB



疊構 Stack up

1. Material	材料種類：	98% Reflective Mirror Aluminum 98%反射率鏡面鋁
2. Layer	層數：	1 ~2L
3. Copper foil	銅箔：	1 oz.
4. Board Thickness	總板厚：	0.95 mm
5. Treatment	表面處理：	ENIG化金
6. Solder Mask	防焊：	White 白
7. Application	產品應用：	LED Lighting 照明



銅基板 Copper Core PCB



疊構 Stack up

1. Material	材料種類：	Copper base 銅板
2. Layer	層數：	1 L
3. Copper foil	銅箔：	1 oz.
4. Board Thickness	總板厚：	3.53 mm
5. Treatment	表面處理：	ENEPIG 鍍鉍金
6. Solder Mask	防焊：	Red 紅
7. Application	產品應用：	LED Lighting 照明
8. Others	其他：	Concave cup 凹杯設計



鋁板 Aluminum PCB



疊構 Stack up

1. Material	材料種類：	5052 Aluminum 5052 鋁
2. Layer	層數：	1 L
3. Copper foil	銅箔：	1 oz.
4. Board Thickness	總板厚：	1.1mm
5. conductivity pp	導熱係數：	k=1-9 w/mk
6. Treatment	表面處理：	H.A.S.L 無鉛噴錫
7. Solder Mask	防焊：	White 白
8. Application	產品應用：	LED Lighting 照明



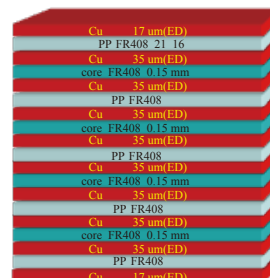
FR-4

FR-4 玻璃纖維板



1. Material	材料種類：	FR-4
2. Layer	層數：	10 L
3. Copper foil	銅箔：	1oz copper
4. Board Thickness	總板厚：	1.6 +/- 0.1 mm
5. Treatment	表面處理：	ENIG 化金
6. Solder Mask	防焊：	Blue 藍
7. Application	產品應用：	Electronic 電子產品

疊構 Stack up



FR-4 玻璃纖維板



1. Material	材料種類：	FR-4
2. Layer	層數：	20 L
3. Copper foil	銅箔：	1oz copper
4. Board Thickness	總板厚：	1.6 +/- 0.1 mm
5. Treatment	表面處理：	ENIG 化金
6. Solder Mask	防焊：	Red 紅
7. Application	產品應用：	Electronic 電子產品

疊構 Stack up

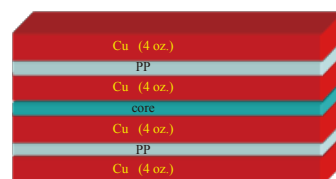


FR-4 厚銅板 Heavy Copper Boards



1. Material	材料種類：	FR-4
2. Layer	層數	4 L
3. Copper foil	銅箔：	4 oz.
4. Board Thickness	總板厚：	3.1mm
5. Treatment	表面處理：	ENIG 化金
6. Solder Mask	防焊：	GREEN 綠
7. Application	產品應用：	Electronic 電子產品

疊構 Stack up



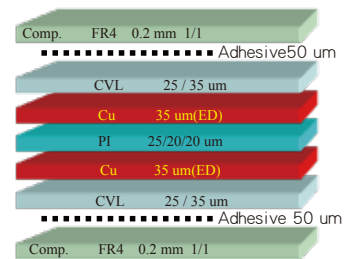
Others

軟硬結合板 Rigid Flex



1.Material	材料種類：	FR4+FPC+FR4
2. Layer	層數：	4 L
3. Copper foil	銅箔：	1oz copper
4. Board Thickness	總板厚：	1.0 +/- 0.1 mm
5. Coverlayer	覆蓋膜：	25/35 um
6. Treatment	表面處理：	ENIG 化金
7. Solder Mask	防焊：	Green 綠
8. Application	產品應用：	Electronic 電子產品

疊構 Stack up

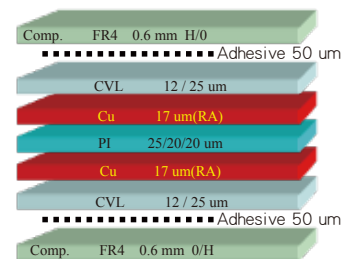


軟硬結合板 Rigid Flex



1.Material	材料種類：	FR4+FPC+FR4
2. Layer	層數：	4 L
3. Copper foil	銅箔：	RA copper
4. Board Thickness	總板厚：	1.6 +/- 0.178 mm
5. Coverlayer	覆蓋膜：	12/25 um
6. Treatment	表面處理：	ENIG 化金
7. Solder Mask	防焊：	Green 綠
8. Application	產品應用：	Electronic 電子產品

疊構 Stack up



Rogers



1. Material	材料種類：	Rogers 4350
2. Layer	層數：	2 L
3. Copper foil	銅箔：	H oz.
4. Board Thickness	總板厚：	0.8mm
5. Treatment	表面處理：	ENIG 化金
6. Solder Mask	防焊：	Green 綠
7. Application	產品應用：	Microwave Communication 微波通訊

疊構 Stack up

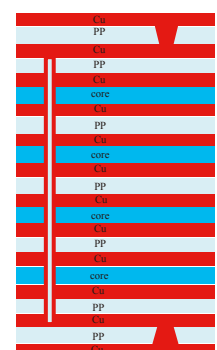


HDI



1. Material	材料種類：	FR-4
2. Layer	層數：	12 L(1+10+1)
3. Board Thickness	總板厚：	1.6mm
4. Treatment	表面處理：	ENIG 化金
5. Solder Mask	防焊：	GREEN 綠
6. Application	產品應用：	Electronic 電子產品

疊構 Stack up





佳總興業股份有限公司 GIA TZOONG ENTERPRISE CO.,LTD.

地址 **Address** : 桃園市大林里興邦路39-4號 (龜山工業區)

No.39-4 Hsing Pong Road,
Taoyuan City, Taiwan, R.O.C.

電話 **TEL** : 886-3-3667382 ● 3625499

傳真 **FAX** : 886-3-3667389 ● 3676010

公司網站 **Website** : <http://www.gia-tzoong.com.tw>

股票代碼 **Stock Code** : 5355

江門佳泰電子有限公司 Jiangmen PSC Electronics LTD.

地址 **Address** : 廣東省江門市新會區古井鎮臨港工業園

Near Port Industrial Park, Gujing Town, Xinhui District,
Jiangmen City, Guangdong, China

電話 **TEL** : 86-750-6298888

傳真 **FAX** : 86-750-6298890

公司網站 **Website** : <http://www.jmpsc.com>